

各 位

2025 年 2 月 12 日  
大阪大学 接合科学研究所  
微細接合学分野  
巽 裕章

**接合科学共同利用・共同研究拠点 先導的重点課題**  
**「特異な構造を内包したマイクロ接合部の高機能・高信頼化に関する研究」**  
**第 3 回勉強会**  
**～半導体デバイスにおける放熱技術と評価技術～**


- 日時 : 2025 年 3 月 13 日 (木) 15:00~16:00  
場所 : 大阪大学 接合科学研究所 2 階 大会議室  
主催 : 大阪大学 接合科学研究所 微細接合学分野  
参加費 : 無料  
趣旨 : 半導体デバイスに用いられるマイクロ接合技術は、車両の電動化の推進や、高速大容量通信の普及、パワエレ機器の需要拡大などの社会的な要求を受けて、近年その重要性が一層増しています。本年度の勉強会では、半導体デバイスにとってますます重要となる放熱技術とその評価技術に焦点を当て、当該分野における近年の研究開発事例についてご講演いただきます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

**講演タイトル :**

**高熱伝導接合部材に対する接触熱抵抗評価試験の高精度化**

**講師 :**

**結城 和久 氏 (山口東京理科大学 工学部機械工学科 教授)**

- 申し込み先 : [https://www8.webcas.net/form/pub/jwri/research\\_workshop](https://www8.webcas.net/form/pub/jwri/research_workshop)  
(申し込み締め切り : 2025 年 3 月 11 日)
- 問い合わせ先 : 大阪大学 接合科学研究所 微細接合学分野 巽 裕章 
- 大阪大学 接合科学研究所では共同研究員を募集しています。積極的なご応募をお待ちしております。  
<http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/joint/index.html>

